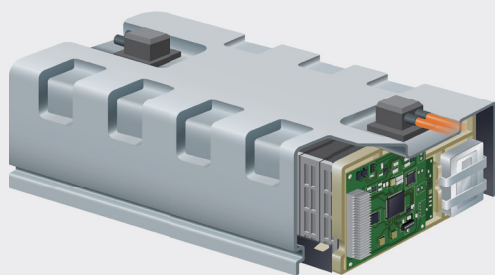


基板用非導電銅膏

擁有 20 年以上車載業界使用實績

用途

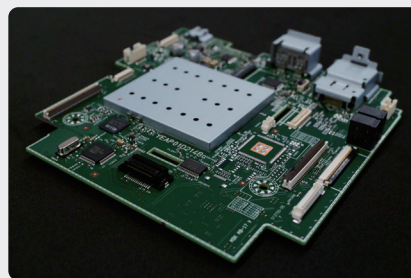
工業用設備，車載應用相關基板（高 Tg）



圖：汽車相關應用



家電應用相關基板（高密度線路）

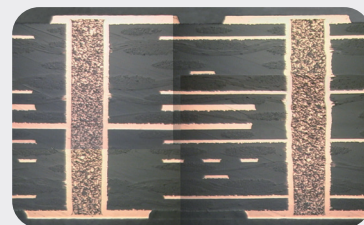


圖：遊戲機



特性

- 對應各種基材或銅箔都有良好的密著性
- 不含溶劑，可有效壓制空洞的發生
- 可有效幫助高密度上件和堆層 (Build-up) 等相關設計



產品型錄和特性表

產品型號			AE1125HD	AE1125DS
黏度	BH型	dPa·s	1,200 ~ 2,000	800 ~ 1,600
固化條件	預熱		80°C × 30分	
	完全固化		160°C × 60分	
體積阻抗率		$\Omega \cdot \text{cm}$	1.0E+09 ~ 1.0E+12	
熱傳導係數 (Laser flash method)		W/m·k	1.4	1.1
玻璃轉化溫度		°C	163	210

